中国半导体产业博览会-2024第6届国际半导体技术展览会

产品名称	中国半导体产业博览会-2024第6届国际半导体技术展览会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

2024第6届深圳国际半导体技术展览会展览时间：2026年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

组织机构：中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、广东省集成电路行业协会、广州市半导体行业协会、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会

我国半导体行业水平的提高、促进了国内外半导体行业技术交流与融合发展、助推了国内外半导体技术设备市场的繁荣。是我国半导体工业应用行业盛会，一年一度集中展示新产品和新技术的重要平台和同世界半导体技术设备界交流的重要窗口；已经被国内外半导体技术设备制造商及相关服务商视为国际盛宴。

中国智能制造业的崛起和全球半导体电子产业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工的日益细化，中国正在成为全球半导体制造的主要生产基地之一，并由此促进了中国半导体产业的快速成长。为进一步提升半导体行业发展，充分展示半导体行业的前沿装备技术，积极推动半导体业界的交流互动，强化半导体行业的交流意识、合作意识，实现相互促进、共同发展，“ 2024深圳国际半导体技术展览会 ”将于2024年05月26日-28日在深圳市国际会展中心（宝安新馆）隆重召开，为半导体行业搭建全方位展示与交流平台。

2024深圳国际半导体技术展览会是国际化的行业盛会，组委会努力全方位打造展会宣传渠道，将高效利用传统电视媒体、报刊、杂志、网络媒体、微信、微博等新兴自媒体，不断引爆企业参展热情。展会官方微信平台现在已有庞大粉丝，形成互动、及时分享展会及行业信息，扩大展会的宣传及影响力度与深度。

本届展会继续加大宣传和推广力度，扩大海外招展范围，不断提高展会国际化水平；组委会也将重点加强半导体设备生产企业观众的组织力度，为中国半导体设备企业走出国门搭建平台。

展示范围一、电子元器件展区：无源器件、半导体分立器件/ IGBT 5G核心元器件特种电子、元器件、电源管理、传感器、储存器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、电位器磁性元件、滤波元件、PCB板、电机风扇电声器件、显示器件、二**管、三**管滤波元件、开关及元器件材料及设备等二、IC设计、芯片展区：IC及相关电子产品设计、人工智能芯片、电源管理芯片、物联网芯片、5G通信芯片及方案、汽车电子芯片、安全控制芯片、数模混合通讯射频芯片、存储芯片、LED照明及显示驱动类芯片等三、半导体设备展区：减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机 、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、固晶机、等离子清洗设备、切割机、装片机、键合机、焊线机、回流焊,波峰焊、测试机、分选机、耦合机、载带成型机、检测设备、恒温恒湿试验箱、传感器、封装模具、测试治具、精密滑台、步进电机、阀门、探针台、洁净室设备、水处理等四、第三代半导体专区：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件（发光二**管LED、激光器LD、探测器紫外）、电力电子器件（二**管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等）、微波射频器件（HEMT、MMIC）五、晶圆制造及封装展区：晶圆制造、SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装载板、印制电路板、封装基板和设备及组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备六、半导体材料展区：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、晶圆胶带、光掩膜版、电子气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料、切片、磨片、抛光片、薄膜等

参展程序

1、参展单位请详细填写《参展申请表》，并加盖公章后传真或交寄至大会组委会。

2、企业报名后3天内将参展费用汇入大会组委会指定帐号，从而确定展位；

3、展位、广告等由组委会统一安排，“ 先申请、先付款、先分配 ”。协办单位可优先安排。

4、为服从展会总体布局，组织单位有权在必要时对个别展台位置进行调整。因不可抗拒的因素如自然灾害，政府行为，社会异常事件等，组织单位可以延迟或取消展会。